

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
20. Januar 2005 (20.01.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/006462 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 51/40**,  
21/48, B29C 59/04

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **POLYIC GMBH & CO. KG** [DE/DE];  
Paul-Gossen-Strasse 100, 91052 Erlangen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2004/001375**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
30. Juni 2004 (30.06.2004)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **FICKER, Jürgen**  
[DE/DE]; Hans-Geiger-Strasse 28, 91052 Erlangen (DE).  
**FIX, Walter** [DE/DE]; Röttenackerstrasse 7, 90427 Nürn-  
berg (DE). **ULLMANN, Andreas** [DE/DE]; Kronstädter  
Strasse 16 a, 90765 Fürth (DE).

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

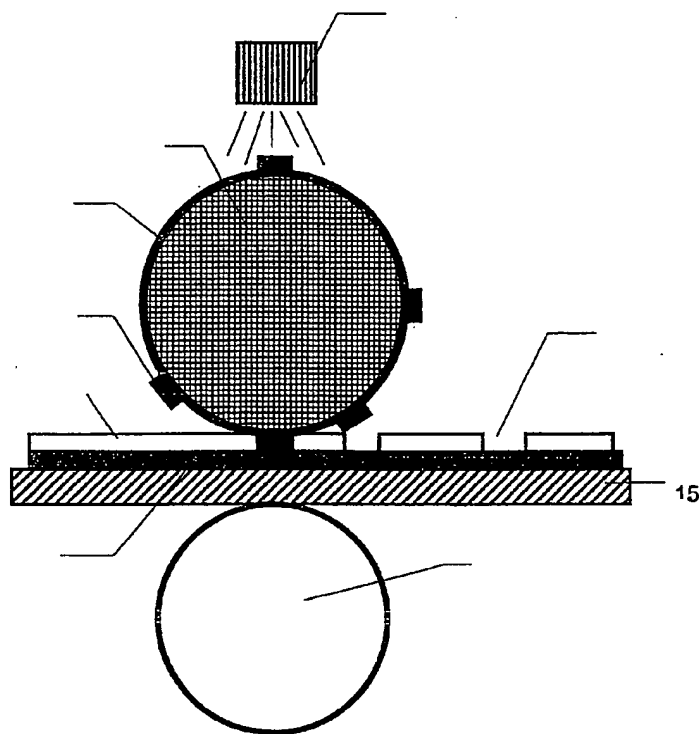
(30) Angaben zur Priorität:  
103 30 062.7 3. Juli 2003 (03.07.2003) **DE**

(74) Anwälte: **ZINSINGER, Norbert** usw.; Louis . Pöhlau .  
Lohrentz, Postfach 30 55, 90014 Nürnberg (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **METHOD AND DEVICE FOR STRUCTURING ORGANIC LAYERS**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STRUKTURIERUNG VON ORGANISCHEN SCHICHTEN**



(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for structuring organic layers. According to a first aspect of the invention, the method is used to structure an unstructured organic layer. Advantageously, the method is used to structure an insulating layer of organic circuits. Structuring means at a pre-determined temperature are pressed into the organic layer by a pre-determined pressure (compression pressure). The compression process is suitable for permanently structuring the organic layer by means of the structuring means.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Strukturierung organischer Schichten. Gemäss einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zum Strukturieren einer unstrukturierten organischen Schicht bereitgestellt. Vorteilhafterweise eignet sich das Verfahren für eine Strukturierung von einer Isolatorschicht von organischen Schaltungen. Strukturierungsmittel, die

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/006462 A1